



ブリッジエンジニア

株式会社デジタルメディアプロフェッショナルでの募集です。 事業企画・事業開発...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル

求人ID

1606305

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区

給与

700万円 ~ 1200万円

勤務時間

09:00 ~ 18:00

休日・休暇

【有給休暇】初年度 10日 4か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW 夏季休暇 年末年始 産前産後休暇 ※有給...

更新日

2026年08月06日 14:17

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2394537】

【仕事内容】

インド市場向けDi1製品の拡販において、現地営業・FAEチームと日本の開発部隊をつなぎ、技術面から案件を推進していただきます。

顧客要望や技術課題を整理し、関係者と連携しながら、PoC・提案・課題解決をリードするポジションです。

▼具体的には

【インド側チームと日本開発部隊の技術ブリッジ】

現地営業・FAEから上がる顧客要望や技術課題を整理し、要件や仕様として日本側の開発部隊へ連携します。

【顧客・パートナーへの技術提案、PoC支援】

製品仕様の説明、技術Q A対応、PoC設計・評価計画の策定、カメラ・AI処理・ソフトウェア構成を含むシステム提案を行います。

【技術課題の整理・解決推進】

課題の切り分け、再現確認、ログ整理、原因分析を行い、優先順位や対応方針を明確にしながら解決まで推進します。

【インド側FAEチームの技術支援】

現地FAEへの技術的なバックアップやレビュー、ナレッジ共有を通じて、インド側での問題解決力向上を支援します。

スキル・資格

【必須スキル】

- ・英語、日本語で社内社外関係者との調整・報告・合意形成など、業務コミュニケーションが可能な方
- ・FAE、SE、技術営業、PM、開発マネジメントなど、顧客対応を伴う技術職の経験
- ・カメラ、組み込み機器、半導体、画像処理、AIエッジ機器など、いずれかの技術知見
- ・顧客要望や技術課題を整理し、関係者と協力して前に進めた経験

【歓迎スキル】

- ・SoC、組み込みLinux、ISPに関する知識
- ・監視カメラ、産業機器、カメラモジュール、映像機器の開発・評価・導入経験
- ・PoC、技術検証、評価計画の策定・推進経験
- ・ODM/EMSなど外部パートナーとの協業経験
- ・海外顧客・海外拠点とのプロジェクト推進経験

【求める人物像】

- ・技術をベースに、顧客や社内外の関係者と前向きにコミュニケーションできる方
- ・複数の関係者を巻き込みながら、課題解決に向けて主体的に動ける方
- ・海外チームとの連携やグローバル案件にチャレンジしたい方
- ・新しい技術や製品知識を学び、成長していく意欲のある方
- ・変化のある環境を楽しみ、柔軟に対応できる方

会社説明

当社は、2002年7月に創業しました（2011年6月に東証マザーズに上場（2022年4月グロース市場に移行）。以来、研究開発型ファブレス半導体ベンダーとして、組み込みシステムにおけるビジュアル・コンピューティング分野を事業の中核とし、独自開発した2D/3Dグラフィックス技術のハードウェアIPやソフトウェアIPのライセンス、およびこれらのIPを搭載したグラフィックスLSIの開発・販売を主な事業としてきました。当社のGPU IPを採用した顧客製品の累計出荷は1億7千万台を超えており、グラフィックスプロセッサ-RS1の売上高も年々増加するなど、成果を出してきました。また、当社の注力分野であるセーフティ分野、ロボティクス分野において、AI/ディープラーニングを活用した画像認識技術を核とした製品・サービスの開発を行っています。当社の強みを生かした画像の知能化により、社会課題の解決に取り組んでいます。【事業内容】・IP コアライセンス事業半導体の設計ノウハウの中でも、3Dグラフィックスを描画する際に必要となる計算処理を行うグラフィックス半導体、いわゆるGPU（Graphics Processing Unit）の機能に特化したIPコア開発とライセンス販売を行っています。この事業には、AIに関連するIPやソフトウェア開発・販売も含まれています。・製品事業当社ではIP製品のライセンスと同時に、当社で自社IPをベースとしたLSI半導体製品を開発し、半導体メーカーに製造を委託したうえで販売しています。当該LSI製品のグラフィックスSoC（RS1）は主にアミューズメント機器等に組み込まれ、エッジAI推論SoC（Di1）はAIを使用する幅広い機器等に組み込まれます。また、協働ロボット向けの画像認識システム（ビジョンシステム）、自律走行ロボットの本体・コンポーネント、ドローン向けカメラモジュール等の製品の仕入、販売を行っています。・プロフェッショナルサービス事業AI製品の研究開発や、お客様の課題解決に向けた受託開発を行っています。既存の技術と最先端技術を組み合わせる新しい解決策を提供したり、ゼロから新技術を生み出しております。安全運転支援システムやロボティクスに係る開発なども含まれます。【強み】1．GPUコア技術：創業以来、世界有数のGPU IPベンダーとしてのコンパクトさ、低消費電力、高性能が実証された最先端のIPを提供しています。任天堂ゲーム機、デジタルカメラ、プリンターなど幅広い採用実績があり、テレビ向けのAI IPコア採用実績も合わせると、顧客製品出荷実績は1.7億台に達しています。2．SoCシステム技術：2D/3D高性能グラフィックスLSIの開発経験を生かし、GPUコア単体の提供だけでなく、IP組込設計からSoM開発までワンストップで対応することが可能です。当社がゲーム機向けに開発したSoCであるRS1は、遊技機業界においてリアルタイム2Dと3Dエンジンを融合した高性能・高圧縮動画エンジンをワンチップに統合しました。臨場感あふれる美しい映像表現によるエンターテインメント性の向上とコストパフォーマンスの両立というシナジー効果がお客様に高く評価されています。また、次世代エッジAI推論SoCであるDi1は、当社独自の高性能AI推論エンジン（ViT/FP4対応）、ハードウェアベースの高精度リアルタイム3D測距エンジン（ステレオビジョン）、および台湾の有力イメージング技術企業であるiCatch Technology社の高性能ISP（Image Signal Processor）をワンチップに統合しています。これにより特に高度な画像AIアプリケーションにおいて、競合製品を凌駕する機能および性能を備えています。・3アルゴリズムからSoC/モジュール化まで一貫した開発力：当社のAIプロセッサIPは、当社がGPU開発で蓄積してきた小型化・省電力化技術を駆使し、演算処理の専用ハードウェア化、内部メモリー搭載による低レイテンシー化、RTL設計によるハードウェア実装の最適化により、アルゴリズム、ソフトウェアだけでは実現不可能なエッジ側アプリケーションに最適な推論処理性能を低消費電力かつ小サイズで実現しています（ハードウェアアクセラレーション）。このように、当社は、AIのアルゴリズム開発、ソフトウェア開発・最適化に加えて、ハードウェアからSoCまで一貫して開発し、お客様のアプリケーションへの最適化をサポートしています。AI業界には、AIのアルゴリズム開発からソフトウェア開発までを行っているプレーヤーはたくさんいますが、ハードウェア化までできるところはあまりないと自負しています。